

專利技術類別與可應用領域對應圖

依 29 件專利之技術內容進行分類，對應可延伸之應用市場與產業方向。



專利總數

29 件



1. 組裝、對位與封裝技術

3 件

代表技術：

ELECTRONIC CASING AND METHOD OF MANUFACTURING、ALIGNMENT METHOD FOR ASSEMBLING SUBSTRATE

可應用領域

- 半導體封裝
- 基板對位
- 電子組裝
- 自動化組裝



2. 精密機構與工具設計

7 件

代表技術：

壓電夾持裝置、輻輪導正裝置、PRESTRESS-ADJUSTABLE PIEZOELECTRIC GRIPPING、扭力扳手、電動手工具

可應用領域

- 精密機械
- 自動化設備
- 夾治具
- 設備零組件
- 工具機



3. 製程設構與真空系統

4 件

代表技術：

真空抽氣系統及其節流閥、高靈敏真空動力引入裝置及真空製程設備、線性翻轉機構及真空設備

可應用領域

- 真空製程
- 顯示器製造
- 半導體設備
- 智慧製造設備



4. 光學感測與檢測技術

4 件

代表技術：

音叉式接觸感測裝置及其感測方法、光學影像擷取模組、對位方法及觀測方法

可應用領域

- 光學檢測
- 精密量測
- AOI
- 智慧感測
- 自動對位



5. 材料、薄膜與印刷製程

6 件

代表技術：

滾輪式微接觸印刷裝置及其印刷方法、薄膜網版印刷系統及方法、化學氣相沉積鍍膜連續鍍製裝置、高均勻化學氣相沉積鍍膜連續鍍製裝置

可應用領域

- 薄膜沉積
- 電子材料
- 表面處理
- 半導體 / 顯示製程
- 印刷電子



6. 醫療器材與復健輔具

5 件

代表技術：

根管阻塞物移除器具、外骨骼輔助裝置、醫療用扭力手工具裝置、MEDICAL TORQUE HAND TOOL

可應用領域

- 牙科器械
- 醫療手工具
- 手術工具
- 智慧醫材
- 復健輔具



應用面向涵蓋：半導體與電子製造、精密機械、自動化設備、光學檢測、材料鍍膜、醫療器材。

註：部分專利可跨領域應用，分類依主要技術內容歸納。